

中国硅酸盐学会

中硅字(2025) 20 号

第 15 届无机非金属材料专题研讨会暨无机非金属材料

材料学科优秀学者论坛第三轮通知

为了促进学科繁荣与发展,充分发挥中国硅酸盐学会的学术交流优势和《硅酸盐学报》、*Journal of Materiomics*、*Advanced Materials Joining* 及《材料科学与工艺》作为开展学术交流、学术争鸣重要园地的作用,第 15 届无机非金属材料专题研讨会暨无机非金属材料学科优秀学者论坛将于 2025 年 8 月 13 日~15 日在黑龙江省哈尔滨市举办。本届研讨会由中国硅酸盐学会主办,哈尔滨工业大学、材料结构精密焊接与连接全国重点实验室、特种环境复合材料技术国家级重点实验室、先进结构功能一体化材料与绿色制造技术工信部重点实验室、中材高新氮化物陶瓷有限公司承办。

一、研讨主题

先进结构陶瓷与复合材料、光电信息材料与器件、陶瓷和异种材料连接及电子封装、陶瓷涂层与薄膜材料、压电铁电与多铁性陶瓷、低维材料与器件、能量转换和存储材料与器件、生物医用与仿生材料、先进玻璃材料、先进晶体材料、高压与超硬材料、先进土木工程材料、先进耐火材料与陶瓷膜、人工智能辅助材料研究等。

二、时间及地点

1、报到时间及地点:

8月13日全天,哈尔滨华旗饭店。

2、会议日期及地点:

8月14日 8:30~18:00, 8月15日 8:30~17:00, 哈尔滨华旗饭店。

3、会议住宿：

哈尔滨华旗饭店及周边协议酒店（马迭尔民防商务酒店、希尔顿酒店、悠融酒店等）。

三、会议组织

大会主席：

高瑞平（中国硅酸盐学会理事长）

南策文（中国科学院院士，清华大学教授）

周 玉（中国工程院院士，哈尔滨工业大学教授）

张清杰（中国科学院院士，武汉理工大学教授）

执行主席：

晋占平（中国硅酸盐学会秘书长）

贾德昌（哈尔滨工业大学特种陶瓷研究所所长，先进
结构功能一体化材料与绿色制造技术工信部重
点实验室主任，教授）

黄陆军（哈尔滨工业大学材料科学与工程学院院长，教授）

组委会秘书长：

曹淑凤（中国硅酸盐学会编辑部主任）

王玉金（哈尔滨工业大学材料结构精密焊接与连接全国
重点实验室副主任，教授）

林铁松（哈尔滨工业大学材料结构精密焊接与连接全国
重点实验室常务副主任，教授）

王亚明（哈尔滨工业大学特种陶瓷研究所副所长，先进
结构功能一体化材料与绿色制造技术工信部重
点实验室副主任，教授）

四、会议注册

1、网络注册

请登录以下网址<https://inmc15.ceramsoc.com/>或扫描二维码进行会议注册、提交摘要和缴费。



请扫描中国硅酸盐学会会员之家
小程序报名参会

2、注册费

2025年7月31日(含7月31日)前支付, 2200元/人(在校学生1200元/人); 2025年8月1日后或现场支付, 2500元/人(在校学生1500元/人)。

如需对公转账, 收款信息为:

户 名: 中国硅酸盐学会

开户银行: 中国工商银行北京百万庄支行

账 号: 0200001409014435189

汇款时请注意: 注明第15届研讨会注册费和参会者姓名; 如为学生请额外注明; 现场提供扫码或现金支付, 请准备刷卡的参会代表提前绑定移动支付软件或提前在网上缴费。

五、会议食宿

1、酒店预订

请扫描以下二维码预订会议协议酒店:



2、会议期间食宿费用自理

六、会议联系

中国硅酸盐学会：

张津溥 (13671252214, zhangjinpu@jccsac.com)

周立忠 (13522585433, zhoulizhong2010@163.com)

哈尔滨工业大学：

学术联系人：

段小明 (13804515316, duanxiaoming@hit.edu.cn)

陈 磊 (13258668288, chenleihit@hit.edu.cn)

蔡德龙 (18345171718, dlcai@hit.edu.cn)

会务联系人：

俞雪勇 (13556018157, 68844061@qq.com)

